

電機工程研究所 碩士在職專班 107 學年度入學課程結構規劃表

課程類別			一年級						二年級					
			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期		
			課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數
專業課程	必修	應修學分數：1 門課/ 應修學分數：6 學分	論文	6	0	論文	6	0	論文	6	0	論文	6	0
	選修	應修課程數：9 門課/ 應修學分數：27 學分	光機電系統整合控制	3	3	影像處理與應用(電、機)	3	3	光機電系統整合控制	3	3	影像處理與應用(電、機)	3	3
			電機控制	3	3	資料探勘與模擬	3	3	電機控制	3	3	資料探勘與模擬	3	3
			現代控制系統	3	3	工業控制器系統設計	3	3	現代控制系統	3	3	工業控制器系統設計	3	3
			資料庫應用程式設計	3	3	數位訊號處理	3	3	資料庫應用程式設計	3	3	數位訊號處理	3	3
			程式設計與演算法	3	3	電玩物理學	3	3	程式設計與演算法	3	3	電玩物理學	3	3
			虛擬實境	3	3	數位控制系統	3	3	虛擬實境	3	3	數位控制系統	3	3
			雲端運算分析與設計	3	3	資料收集與監控系統	3	3	雲端運算分析與設計	3	3	資料收集與監控系統	3	3
			光學工程	3	3	光纖通訊	3	3	光學工程	3	3	光纖通訊	3	3
			光電元件與感測技術	3	3	色彩工程學	3	3	光電元件與感測技術	3	3	色彩工程學	3	3
			表面與界面分析	3	3	金屬氧化物薄膜	3	3	表面與界面分析	3	3	金屬氧化物薄膜	3	3
			光電實驗	3	3	薄膜光學設計與薄膜技術	3	3	光電實驗	3	3	薄膜光學設計與薄膜技術	3	3
			光電半導體	3	3	最佳化方法	3	3	光電半導體	3	3	最佳化方法	3	3
			資料探勘(新增課程)	3	3	半導體感測器	3	3	資料探勘(新增課程)	3	3	半導體感測器	3	3
						智慧型系統(電、機)	3	3				智慧型系統(電、機)	3	3
			奈米半導體元件製程	3	3				奈米半導體元件製程	3	3			

備註：

- 一、畢業總學分數為 33 學分。
- 二、必修 6 學分，選修 27 學分。
- 三、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認列為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認列為外系課程學分。
- 四、學院或系所開設之教學實習微學分課程列為畢業學分。
- 五、系所訂定條件（學程、檢定、證照、承認外系學分及其他）：
  - (一)每學期可選修本所一般碩士班課程 6 學分。
  - (二)課程表中課程標誌為（電、機）表示該課程為本所及機械系都有開設之課程，餘為本所開設之課程。
  - (三)透過國際合作關係到國外相關學校修習相關課程，需經指導教授同意，由他校出具修課證明，本所承認其學分，以 11 學分數為上限。
  - (四)論文為必修。
  - (五)經本所（108.4.30）107 學年度第 4 次所課程委員會會議審議通過。